



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11)	(21)	Patenttihakemus - Patentansökan	921810
(51)	Kv.1k.5 - Int.c1.5		
	C 25D 5/02, B 05D 8/04, 5/10		
(22)	Hakemispäivä - Ansökningsdag	23.04.92	
(24)	Alkupäivä - Löpdag	26.03.91	
(41)	Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	23.04.92	
(86)	Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/US91/02026	
(32)	(33) (31) Etuoikeus - Prioritet		
	24.08.90 US 572849 P		

(71) Hakija - Sökande

1. Gould Inc., 35129 Curtis Boulevard, Eastlake, Ohio 44095-4001, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Whewell, Christopher J., 11631 Lyman Road, Chesterland, Ohio 44026, USA, (US)

2. Clouser, Sidney J., 11960 Aquilla Road, Chardon, Ohio 44024, USA, (US)

3. Lee, Chin-ho, 2060 Edenhall Drive, Lyndhurst, Ohio 44124, USA, (US)

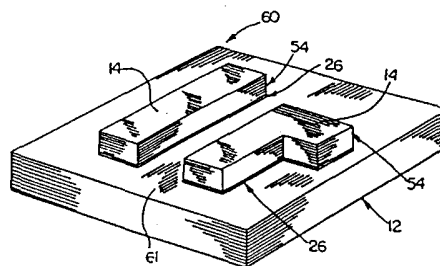
(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä painokytchentävykuvioiden tekemiseksi käyttäen selektiivisesti syövytettäviä metallikerroksia
Förfarande för att göra mönsterkortmönstren genom användande av selektivt etsbara metallskikt

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Tämä keksintö kohdistuu menetelmään suuri-tiheyksisten elektronisten piirilevyjen (10) valmistamiseksi, joka menetelmä käsittää vaiheet, jossa kerrostetaan ensimmäisen metallin kerros (26) foliokerrokselle (20) komposiitin (29) valmistamiseksi, minkä jälkeen kiinnitetään komposiitti (29) eristävään tukiaineeseen (12) laminaatin (31) valmistamiseksi. Foliokerros (20) poistetaan sitten ensimmäisen metallin kerrokselta (26). Valosuoja levitetään sitten ensimmäisen metallin kerrokselle (26), valotetaan ja kehitetään. Valosuojan kehityksen aikana osia valosuojasta (44) poistuu ensimmäisen metallin kerrokselta (26). Kolmannen metallin kerros (54) kerrostetaan sitten ensimmäisen metallin kerroksen (26) niille osille, joita ei ole peitetty valosuojalla (44). Kaikki jäljellä oleva valosuoja (44) ja ensimmäisen metallin kerroksen (26) ne osat, joita ei ole peitetty kolmannella metallilla (54), poistetaan sitten, jolloin saadaan valmis hienoviivainen malline (60), jossa on johtavia (14) ja eristäviä alueita (61). Valmistusta hienoviivaista mallinetta (60) voidaan sitten käyttää piirilevyn valmistukseen.



Jatkuu seur. sivulla
Forts. nästa sida

Denna uppfinning avser ett förfarande för framställning av elektroniska kretskort (10) med hög täthet, vilket förfarande omfattar steg, vid vilka ett skikt (26) av en första metall deponeras på ett folieskikt (20) för att bilda en komposit (29), varpå kompositen (29) fästs på ett isolerande underlag (12) för att åstadkomma ett laminat (31). Folieskiktet (20) avlägsnas därpå från skiktet av en första metall (26). Ett ljusskydd läggs därefter på skiktet av den första metallen (26), exponeras och framkallas. Under framkallningen av ljusskyddet avlägsnas avsnitt av ljusskyddet (44) från skiktet av den första metallen (26). Ett skikt av en tredje metall (54) pläteras därefter på de avsnitt av skiktet av den första metallen (26), vilka ej täcks av ljusskyddet (44). Allt återstående ljusskydd (44) och de avsnitt av skiktet av den första metallen (26), som ej täcks av den tredje metallen (54), avlägsnas därpå åstadkommande ett finlinjemönster (60) med ledande (14) och isolerande ytor (61). Finlinjemönstret (60) kan sedan användas för framställning av ett kretskort.